

(19)日本国特許庁 ( J P )

(12) 公 開 特 許 公 報 ( A )

(11)特許出願公開番号

特開2002 - 76314

(P2002 - 76314A)

(43)公開日 平成14年3月15日(2002.3.15)

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テ-マコード <sup>*</sup> ( 参考 )
H 0 1 L 27/14		A 6 1 B 1/04 372	4 C 0 6 1
A 6 1 B 1/04	372	H 0 4 N 5/225	D 4 M 1 1 8
H 0 1 L 27/148			C 5 C 0 2 2
31/02		5/335	V 5 C 0 2 4
H 0 4 N 5/225		7/18	M 5 C 0 5 4

審査請求 未請求 請求項の数 5 O L ( 全 7 数 ) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000 - 261654(P2000 - 261654)

(22)出願日 平成12年8月30日(2000.8.30)

(71)出願人 390020248  
日本テキサス・インスツルメンツ株式会社  
東京都新宿区西新宿六丁目24番1号

(72)発明者 小師 敦  
茨城県稲敷郡美浦村木原2350番地 日本テ  
キサス・インスツルメンツ株式会社内

(72)発明者 山下 友和  
茨城県稲敷郡美浦村木原2350番地 日本テ  
キサス・インスツルメンツ株式会社内

(74)代理人 100094053  
弁理士 佐藤 隆久

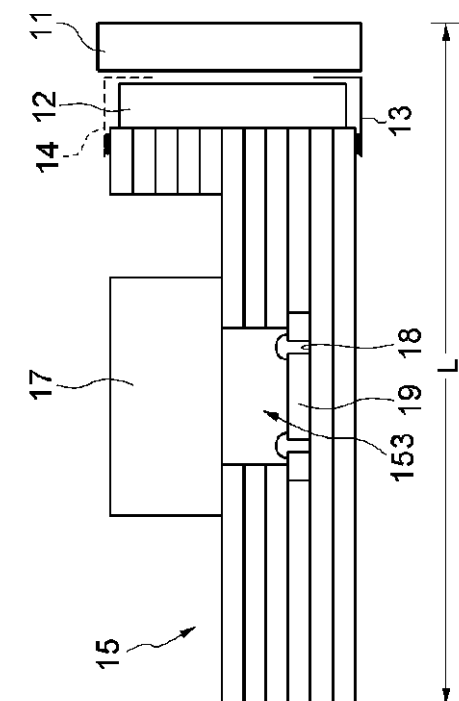
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 超小型撮像装置

(57)【要約】

【課題】 長さを短縮した、医療用電子内視鏡などに適用する超小型ＣＣＤ撮像装置を提供する。

【解決手段】 超小型ＣＣＤ撮像装置１は、その長手方向に沿って下記の順序で配設された、光学ガラス１１と、ＣＣＤチップ１２と、積層回路基板１５を有し、さらに、ＣＣＤチップ１２と積層回路基板１５に搭載された電子回路とを接続するＴＡＢテープ１３を有する。積層回路基板１５は、それぞれが配線パターンを含む電子回路を実装した絶縁回路基板を上記長手方向と直交する径方向に複数層積層して形成され、径方向に凹陷して形成された少なくとも１つのキャビティ１５３を有している。キャビティ１５３内に少なくとも１つの小型チップ部品１６が装着され、キャビティ１５３の上の積層回路基板１５の表面に少なくとも１つのチップ部品１７が装着されている。積層回路基板１５に電子回路を積層し、チップ部品１６、１７を径方向に配設して、超小型ＣＣＤ撮像装置１の長さを短縮した。



1A

**【特許請求の範囲】**

【請求項 1】撮像デバイスと、上記撮像デバイスの表面側に設けられた光学ガラスと、上記撮像デバイスの裏面側に設けられ、配線パターンを有する積層回路基板と、上記撮像デバイスと上記積層回路基板の配線パターンとを電気的に接続する接続部材とを有する超小型撮像装置であって、  
上記積層回路基板は、配線パターンを含む電子回路を実装した絶縁回路基板を超小型撮像装置の長手方向と直交する径方向に複数積層して形成され、その径方向に凹陷して形成されたキャビティを有し、  
上記キャビティ内に第 1 の電子部品が装着され、上記積層回路基板の表面に第 2 の電子部品が装着されている超小型撮像装置。

【請求項 2】上記第 1 の電子部品が上記キャビティの底面に形成された配線パターンに接続されている請求項 1 に記載の超小型撮像装置。

【請求項 3】上記第 1 の電子部品がベアチップの状態であって上記キャビティ内に装着されている請求項 1 又は 2 に記載の超小型撮像装置。

【請求項 4】上記撮像デバイスが CCD デバイスである請求項 1、2 又は 3 に記載の超小型撮像装置。

【請求項 5】上記接続部材が TAB テープである請求項 1、2、3 又は 4 に記載の超小型撮像装置。

**【発明の詳細な説明】****【0001】**

【発明の属する技術分野】本発明は、たとえば、医療用電子内視鏡の先端に使用されるチャージカップルドデバイス (CCD) などを用いた撮像装置に関するものであり、特に、長手方向の長さの短縮を図った超小型撮像装置に関する。

**【0002】**

【従来の技術】超小型撮像装置として医療用電子内視鏡に用いる超小型 CCD 撮像装置を例示する。医療用電子内視鏡に用いる超小型 CCD 撮像装置は、たとえば、患者の胃の検査をする場合、超小型 CCD 撮像装置を飲み込んで検査を受ける患者の苦痛を緩和するため、可能な限り小型化が図られている。そのような小型化の試みとしては、超小型 CCD 撮像装置の先端部の外径寸法の小型化と、超小型 CCD 撮像装置の長さの縮小化がある。外径寸法の小型化と、長さの縮小化は共に、たとえば、患者の口から胃に至る食道などの経路を超小型 CCD 撮像装置が通過するときの案内の容易さと患者の肉体的な苦痛を軽減することになる。さらに、超小型 CCD 撮像装置の小型化は検査すべき胃の内部における運動の自由度を高めることができ検査内容の向上に寄与するし、検査中患者の肉体的な苦痛を軽減する。

【0003】医療用電子内視鏡に用いる超小型 CCD 撮像装置は、たとえば、図 3 に例示したように、光学ガラス 21 と、CCD チップ 22 と、セラミック 28 と、リ

ード 29 と、絶縁回路基板 25 とが図解のごとく超小型 CCD 撮像装置の長手方向に並んで配設されている。

【0004】絶縁回路基板 25 には、CCD チップ 22 の撮像結果を信号処理して患者の外部に取り出すことを可能にするための信号処理用電子回路、たとえば、トランジスタ、キャパシタなどのチップ部品 26、27 が搭載されている。また絶縁回路基板 25 には、外部から CCD チップ 22 を駆動させるための電源を供給するための給電線も収容されている。

【0005】TAB (Tape Automated Bonding) テープ 23、24 が、CCD チップ 22 とリード 29 との間に配設されていて、CCD チップ 22 の電極とリード 29 内に形成された配線パターンとの間を接続している。TAB テープ 23、24 はさらに、CCD チップ 22 への給電を行う給電線としての役割を持つ。なお、TAB テープは、1 個のみ、たとえば、TAB テープ 23 のみでもよいし、図解のごとく、TAB テープ 23 の他に、TAB テープ 24 など複数配設することもできる。

【0006】リード 29 が、TAB テープ 23 を介して、CCD チップ 22 と、絶縁回路基板 25 の表面に形成された配線パターンにハンダ付けされており、絶縁回路基板 25 に搭載された第 1 のチップ部品 26 および第 2 のチップ部品 27 との接続のために設けられている。このように、図 3 の超小型 CCD 撮像装置 2 においては、CCD チップ 22 と絶縁回路基板 25 との間を、TAB テープ 23 とリード 29 とで接続している。

【0007】超小型 CCD 撮像装置 2 のこれらの構成物は一体化され、患者の食道の内壁に接触したり、胃壁に接触してもそれらを傷つけないように超小型 CCD 撮像装置 2 の外面が処理されている。なお、超小型 CCD 撮像装置には胃内などの検査部位を照明するために、たとえば、光ファイバを介して外部から光が印加されるが、照明器具は本発明には直接関係しないので、図解を省略している。

【0008】このように構成された超小型 CCD 撮像装置 2 には、超小型 CCD 撮像装置 2 を食道の内壁などに案内していく、ある程度の強度がある可撓性のあるケーブル (図解なし) が接続されている。そのケーブルの内部には、CCD チップ 22 に電力を供給する給電線と、照明用の光ファイバと、CCD チップ 22 で撮像した映像信号を伝送して患者の外部に取り出すための信号伝送用電線、たとえば、光ファイバが収容されている。

【0009】たとえば、超小型 CCD 撮像装置 2 が患者の胃内に到達すると、図解しない照明器具により胃内の検査部位が明るくされ、CCD チップ 22 で撮像した結果が電気信号として取り出され、TAB テープ 23 およびリード 29 を経由して絶縁回路基板 25 に搭載された信号処理を行うチップ部品 26、27 で信号処理されて、その結果が、ケーブルを経由して患者の外部に取り出され、医療用電子内視鏡の本体部の表示装置に出力さ

れる。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】図3に図解した超小型CCD撮像装置2においては、チップ部品26、27を搭載した絶縁回路基板25をリード29に手作業でハンダ付けしており、手作業が必要なうえ、加工時間が長いという問題があった。

【0011】さらに、絶縁回路基板25に第1のチップ部品26と第2のチップ部品27とが長手方向に並んで配設されており、絶縁回路基板25の長さが長くなる。10 その結果として、超小型CCD撮像装置2の長さL1の縮小には限界があった。図3に例示したチップ部品は2個だけであるが、チップ部品の数が多くなると、その数に応じて超小型CCD撮像装置2の長手方向の長さが長くなる。

【0012】したがって、本発明の目的は超小型CCD撮像装置の長手方向の長さを縮小できる超小型撮像装置を提供することにある。

【0013】本発明の他の目的は、組み立て加工などの作業を軽減し、加工時間を短縮できる超小型撮像装置を20 提供することにある。

【0014】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明の超小型撮像装置は、撮像デバイスと、上記撮像デバイスの表面側に設けられた光学ガラスと、上記撮像デバイスの裏面側に設けられ、配線パターンを有する積層回路基板と、上記撮像デバイスと上記積層回路基板の配線パターンとを電気的に接続する接続部材とを有する超小型撮像装置であって、上記積層回路基板は、配線パターンを含む電子回路を実装した絶縁回路基板を超30 小型撮像装置の長手方向と直交する径方向に複数積層して形成され、その径方向に凹陷して形成されたキャビティを有し、上記キャビティ内に第1の電子部品が装着され、上記積層回路基板の表面に第2の電子部品が装着されている。上記撮像デバイスは、好適には、CCDデバイスである。上記接続部材は、好適には、TABテープである。

【0015】超小型撮像装置をこのように構成すれば、第1の電子部品と第2の電子部品とが、長手方向と直交する径方向に重なった位置に配設されることが可能とな30 るので、超小型撮像装置の長手方向の長さを短縮できる。さらに、配線パターンを含む電子回路を長手方向と直交する径方向に積層して実装しているので、超小型撮像装置の長手方向の長さを一層短縮できる。なお、このような電子回路を積層する実装技術は既存の電子回路の実装技術が適用できる。

【0016】加えて、CCDなどの撮像デバイスの電極と積層回路基板との電気的な接続をTABテープなどの接続部材により行い、従来のような、ハンダ付けを行うリードを用いないので、加工も楽であり、組み立て加工50

時間も短縮できる。

【0017】好適には、上記キャビティ内に装着された第1の電子部品は、上記キャビティの底面に形成された配線パターンに接続されている。

【0018】また好適には、上記キャビティ内に装着された第1の電子部品は、ベアチップの形態で上記キャビティの底面に形成された配線パターンに接続されている。

【0019】

【発明の実施の形態】以下、本発明の超小型撮像装置の実施の形態を添付図面を参照して述べる。なお、本発明の超小型撮像装置の実施の形態として、医療用電子内視鏡の先端に使用するCCDデバイスを用いた超小型CCD撮像装置について述べる。

【0020】第1実施の形態

図1(A)、(B)を参照して本発明の第1実施の形態の超小型CCD撮像装置について述べる。図1(A)は超小型CCD撮像装置1の断面図であり、図1(B)は正面図である。超小型CCD撮像装置1は、その長手方向に配設された、光学ガラス11と、CCDチップ12と、積層回路基板15とを有する。

【0021】光学ガラス11の内面とCCDチップ12の一方の面とが面接し、CCDチップ12の他面が積層回路基板15の端面と面接している。

【0022】半導体デバイスの実装技術として知られている、TAB(Tape Automated Bonding、タブ)テープ13が、CCDチップ12の電極と積層回路基板15の配線パターンとに接続されている。このTABテープ13により、外部からCCDチップ12に駆動電力が給電されてCCDチップ12が動作可能となり、CCDチップ12の撮像結果信号が積層回路基板15に伝送される。TABテープ13のCCDチップ12への接続は、たとえば、ハンダ付けで行い、同様に、TABテープ13の積層回路基板15への接続は積層回路基板15の表面に形成された配線パターンへのハンダ付けで行う。必要に応じてTABテープ13に加えて、破線で示したように、第2のTABテープ14を配設することもできる。

【0023】積層回路基板15は、配線パターンを含む電子回路(電子部品)を実装した絶縁基板を複数枚重ねて一体化したものである。複数の絶縁基板に実装された電子部品相互の電気的な接続は、たとえば、半導体回路技術において公知のビア(via)ホールなどに充填された導電性物質を介して行う。

【0024】絶縁基板としては、薄膜状態でも高い絶縁能力があり、機械的な強度が高く、配線パターンを含む電子回路の実装も容易で、放熱性に優れているものが好ましい。そのような絶縁基板としては、たとえば、セラミック基板が好ましい。絶縁基板に実装される電子回路(電子部品)としては、高さが嵩張らない電子部品、た

例えば、プリント配線パターン（導電パターン）、薄膜コンデンサ、薄膜抵抗素子などがあり、これらの電子回路は、CCDチップ12の撮像信号を前処理して小型チップ部品16、大型チップ部品17などに導く。絶縁基板に実装される他の部品として、外部からCCDチップ12の駆動電力を供給するためのプリント配線パターンも含まれる。

【0025】本実施の形態の積層回路基板15は、CCDチップ12に面接する側の高部152と、低平坦部151とから構成されている。

【0026】低平坦部151にはキャピティ（内腔）153が形成されており、キャピティ153の内部には、CCDチップ12の撮像信号について信号処理を行ってケーブルを介して患者の外部の医療用電子内視鏡に送出する電子回路、たとえば、トランジスタ、大きなコンデンサ（キャパシタ）などを収納したチップ部品16が実装されている。チップ部品16はキャピティ底面154に形成された配線パターンに電気的に直接接続されている。チップ部品16はキャピティ壁面155とは離れており、キャピティ153内にチップ部品16を実装した

後、空隙には絶縁性充填物、たとえば、エポキシ樹脂が充填される。

【0027】チップ部品16の上部に位置する部分に、チップ部品16と協働してCCDチップ12の撮像信号について信号処理を行ってケーブルを介して患者の外部に位置する医療用電子内視鏡に送出する電子回路、たとえば、トランジスタ、比較的大きなコンデンサ（キャパシタ）などを収納した大型の電子部品、および/または、複数の電子部品を収納したチップ部品17が、絶縁性充電物質を介して、キャピティ153を覆うように、

低平坦部151の表面に実装されている。このチップ部品17の実装方法としては、低平坦部151の表面に形成された配線パターンに直接電気的に接続されている。

【0028】チップ部品16とチップ部品17との寸法を比較すると、チップ部品17の平面寸法はチップ部品16の平面寸法より大きい。したがって、本明細書において、チップ部品16を小型チップ部品16、チップ部品17を大型チップ部品17と呼ぶ。

【0029】本実施の形態における大型チップ部品17は、たとえば、高さ0.8mm、幅0.8mm、長さ1.6mm（1608サイズ）のコンデンサであり、小型チップ部品16は、たとえば、高さ0.5mm、幅0.5mm、長さ1.0mm（1005サイズ）または高さ0.3mm、幅0.3mm、長さ0.6mm（0603サイズ）の微小な電子部品である。

【0030】図解した超小型CCD撮像装置1のこれらの構成物は一体化され、患者の食道の内壁に接触したり胃壁に接触してもそれらを傷つけないように超小型CCD撮像装置2の外周が処理されている。

【0031】積層回路基板15には、医療用電子内視鏡

に接続される伝送用電線と、CCDチップ12への給電線とが収容され、積層回路基板15を患者の食道などを安定するように構成されたある程度の強度を持った可撓性のある案内ケーブルが接続される。案内ケーブルには、外部の医療用電子内視鏡からCCDチップ12に給電を行うための給電線と、医療用電子内視鏡の照明器具の光を超小型CCD撮像装置1の先端に導く光ファイバと、CCDチップ12の撮像信号を積層回路基板15で信号処理した結果を外部の医療用電子内視鏡に導く信号伝送線、たとえば、光ファイバあるいは導電性電線が収容されている。

【0032】超小型CCD撮像装置1を胃内の検査に使用する場合、外部の医療用電子内視鏡からの照明光が光ファイバで導かれて超小型CCD撮像装置1の先端付近を照明し、その明かりで撮像する機会が多いが、照明手段は本発明には直接関係しないので、図解と記述を割愛する。

【0033】たとえば、可撓性のある案内ケーブルに案内されて超小型CCD撮像装置1が患者の食道を通り、胃内に到達すると、外部の医療用電子内視鏡の照明器具の光が光ファイバで導かれて胃内を明るくし、CCDチップ12で撮像した結果が、TABテープ13を経由して積層回路基板15に導かれ、積層回路基板15の配線パターン、電子回路を経由して小型チップ部品16、大型チップ部品17に到達し、これらチップ部品16、17において所望の信号処理が行われて、ケーブルを経由して患者の外部に取り出され、医療用電子内視鏡の本体部の表示装置に出力される。

【0034】図1（A）、（B）に図解した超小型CCD撮像装置1は、配線パターン、薄膜電子部品が複数の絶縁基板を積層した積層回路基板15に組み込まれているので、積層回路基板15の長手方向の長さが、図3に図解した絶縁回路基板25の長さより短縮できる。加えて、図1（A）、（B）に図解した超小型CCD撮像装置1は、小型チップ部品16と大型チップ部品17とが超小型CCD撮像装置1の長手方向と直交する径方向に2段に重なった状態で積層セラミック回路基板15に実装されているので、積層回路基板15の長手方向の長さを図3に図解した絶縁回路基板25の長さに比べて大きく短縮できる。

【0035】たとえば、図3に図解した超小型CCD撮像装置2の長さL1は、6.4mmであったが、本願の第1実施の形態の超小型CCD撮像装置1の長さLは、4.5mmであり、約2mm程度（約30%）短縮できた。

【0036】さらに、超小型CCD撮像装置1においては、CCDチップ12と積層回路基板15に搭載（実装）された電子回路との接続は、TABテープ13のみで行い、図3に図解したリード29を用いたハンダ付け作業を行わない。その結果として、組み立ても容易であ

り、組み立て加工時間が大幅に短縮できた。このように構造を持つ本発明の超小型 C C D 撮像装置 1 の組み立て作業は、自動化に適している。

#### 【0037】第2実施の形態

図2を参照して本発明の第2実施の形態の超小型 C C D 撮像装置について述べる。図2は本発明の第2実施の形態の超小型 C C D 撮像装置 1 A の断面図である。図2に図解した超小型 C C D 撮像装置 1 A は、その長手方向に配設された、光学ガラス 11 と、C C D チップ 12 と、積層回路基板 15 とを有する。これらの構成は配置は第1実施の形態と同じである。積層回路基板 15 も、第1実施の形態と同様の構成である。T A B テープ 13 によって C C D チップ 12 と積層回路基板 15 との電気的な接続を行うことも第1実施の形態と同様である。

【0038】第2実施の形態においては、図1の小型チップ部品 16 を、半導体実装技術として公知のベアチップ 19 としてキャビティ 153 内の電気接続面 18 に実装している点が異なる。キャビティ 153 のベアチップ 19 を実装した後の空間にはエポキシ樹脂などの絶縁性充填物が充填される。大型チップ部品 17 の実装方法は第1実施の形態と同様である。

【0039】図2に図解した超小型 C C D 撮像装置 1 A も、第1実施の形態の超小型 C C D 撮像装置 1 と同様、配設パターン、薄膜電子部品が複数の絶縁基板を積層した積層回路基板 15 に組み込まれているので、積層回路基板 15 の長手方向の長さが、短縮できた。また、図2に図解した超小型 C C D 撮像装置 1 A も、第1実施の形態の超小型 C C D 撮像装置 1 と同様、小型チップ部品 16 と大型チップ部品 17 とが超小型 C C D 撮像装置 2 の長手方向と直交する径方向に2段に重なった状態で積層回路基板 15 に実装されているので、積層回路基板 15 の長手方向の長さが短縮できた。第2実施の形態の超小型 C C D 撮像装置 1 A の長手方向の長さも、第1実施の形態と同様に短縮できた。

【0040】第2実施の形態の超小型 C C D 撮像装置 1 A も、リードを用いたハンダ付け作業が不要であり、組み立て加工時間が大幅に短縮できた。第2実施の形態の超小型 C C D 撮像装置 1 A も組み立て作業を自動化することができる。

【0041】上述した実施の形態は、撮像デバイスとして C C D チップを用いた超小型 C C D 撮像装置の主要部のみを記述したので、本発明に直接関係がない部分の図解を省略しているが、本発明の超小型撮像装置はそのような公知の部分、たとえば、本願発明の超小型 C C D 撮像装置を医療用電子内視鏡に使用する場合の照明器具な\*

\*どをも包含する。

【0042】本発明の超小型撮像装置の実施に際しては、上述した実施の形態には限定されず、明細書の特許請求の範囲に記載された本願発明で規定された内容を含むことは当業者にとって自明である。たとえば、本願発明の超小型撮像装置は医療用電子内視鏡への用途に限定される訳ではない。医療用電子内視鏡と同様、小型の超小型撮像装置が必要な場合、本願発明の超小型撮像装置を適用することができる。

【0043】本発明の撮像デバイスとして、広く使用されている C C D チップ 12 を用い、本発明の接続手段として T A B テープ 13 を用いた場合について例示したが、本発明はもちろん、このような例示に限定されるものではない。このような回路と実質的に同様な他の回路を適用できることは勿論である。

#### 【0044】

【発明の効果】本発明の超小型撮像装置によれば、長手方向の長さを短縮できた。

【0045】また本発明の超小型 C C D 撮像装置は自動化組み立てが可能であり、組み立て加工時間が短縮できた。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明の超小型 C C D 撮像装置の第1実施の形態の構成を示す図であって、図1(A)は断面図であり、図1(B)は平面図である。

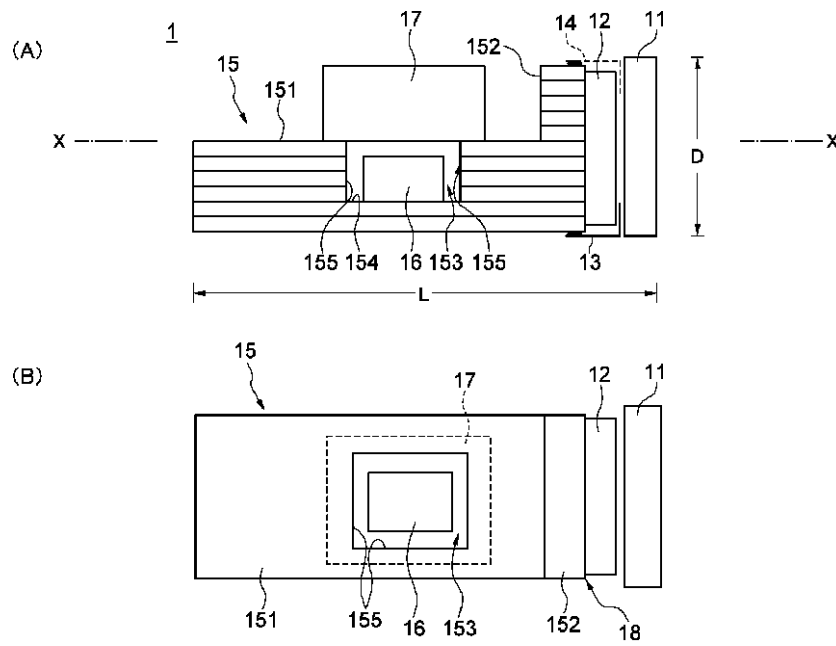
【図2】図2は本発明の超小型 C C D 撮像装置の第2実施の形態の構成を示す断面図である。

【図3】図3は従来の超小型 C C D 撮像装置の構成を示す断面図である。

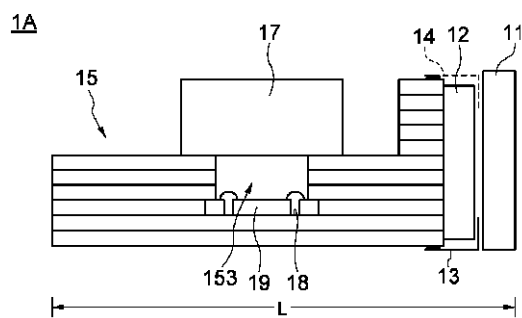
#### 【符号の説明】

- 1、1 A・・・超小型 C C D 撮像装置、
- 11・・・光学ガラス、12・・・C C D チップ、
- 13、14・・・T A B テープ、
- 15・・・積層回路基板
- 151・・・低平坦部、152・・・高部、
- 153・・・キャビティ（内腔）、
- 154・・・キャビティ底面、155・・・キャビティ壁面
- 16、17・・・チップ部品、18・・・電気接続面、
- 19・・・ベアチップ
- 2・・・超小型 C C D 撮像装置、
- 21・・・光学ガラス、
- 22・・・C C D チップ、
- 23、24・・・T A B テープ、25・・・絶縁回路基板、
- 26、27・・・チップ部品、28・・・セラミック、29・・・リード

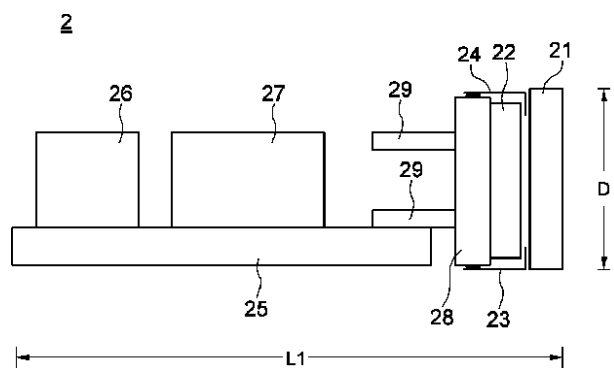
【図 1】



【図 2】



【図 3】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>7</sup>

H 0 4 N 5/225  
5/335  
7/18  
H 0 5 K 1/18  
3/46

識別記号

F I

H 0 5 K 1/18  
3/46  
H 0 1 L 27/14  
31/02

テ-マ-ド (参考)

Q 5 E 3 3 6  
Q 5 E 3 4 6  
D 5 F 0 8 8  
B  
B

F ターム(参考) 4C061 AA00 BB02 CC06 DD00 JJ06  
LL02 NN01 PP08 SS01  
4M118 AA10 AB01 BA10 FA06 HA02  
HA22 HA23 HA24 HA25 HA33  
5C022 AA09 AB43 AC42 AC51 AC70  
AC77  
5C024 AX01 BX02 CY48 EX23 EX25  
GY01  
5C054 AA05 CA04 CE04 DA08 HA12  
5E336 AA08 AA11 AA12 BB03 BB18  
BC12 BC26 BC31 CC31 DD23  
DD39 EE01 GG14  
5E346 AA51 BB20 CC16 EE21 FF45  
GG28 HH22 HH31  
5F088 AA01 BB03 BB07 EA04 JA03

专利名称(译)	超紧凑的成像设备		
公开(公告)号	<a href="#">JP2002076314A</a>	公开(公告)日	2002-03-15
申请号	JP2000261654	申请日	2000-08-30
申请(专利权)人(译)	德州仪器日本有限公司		
[标]发明人	小師敦 山下友和		
发明人	小師 敦 山下 友和		
IPC分类号	A61B1/04 H01L27/14 H01L27/148 H01L31/02 H04N5/225 H04N5/335 H04N5/372 H04N7/18 H05K1/18 H05K3/46		
CPC分类号	H04N5/2251 H01L2224/48091 H01L2224/48227 H04N5/2253 H04N2005/2255 H05K1/183 H05K3/4611 H01L2924/00014		
FI分类号	A61B1/04.372 H04N5/225.D H04N5/225.C H04N5/335.V H04N7/18.M H05K1/18.Q H05K3/46.Q H01L27/14.D H01L27/14.B H01L31/02.B A61B1/04.530 A61B1/05 H01L27/146.D H01L27/148.B H04N5/225 H04N5/335.720 H04N5/372		
F-TERM分类号	4C061/AA00 4C061/BB02 4C061/CC06 4C061/DD00 4C061/JJ06 4C061/LL02 4C061/NN01 4C061/PP08 4C061/SS01 4M118/AA10 4M118/AB01 4M118/BA10 4M118/FA06 4M118/HA02 4M118/HA22 4M118/HA23 4M118/HA24 4M118/HA25 4M118/HA33 5C022/AA09 5C022/AB43 5C022/AC42 5C022/AC51 5C022/AC70 5C022/AC77 5C024/AX01 5C024/BX02 5C024/CY48 5C024/EX23 5C024/EX25 5C024/GY01 5C054/AA05 5C054/CA04 5C054/CE04 5C054/DA08 5C054/HA12 5E336/AA08 5E336/AA11 5E336/AA12 5E336/BB03 5E336/BB18 5E336/BC12 5E336/BC26 5E336/BC31 5E336/CC31 5E336/DD23 5E336/DD39 5E336/EE01 5E336/GG14 5E346/AA51 5E346/BB20 5E346/CC16 5E346/EE21 5E346/FF45 5E346/GG28 5E346/HH22 5E346/HH31 5F088/AA01 5F088/BB03 5F088/BB07 5F088/EA04 5F088/JA03 4C161/AA00 4C161/BB02 4C161/CC06 4C161/DD00 4C161/JJ06 4C161/LL02 4C161/NN01 4C161/PP08 4C161/SS01 5C122/DA26 5C122/EA54 5C122/EA57 5C122/FB01 5C122/FC01 5C122/GE07 5C122/GE11 5C122/GE18 5C122/HA34 5E316/AA51 5E316/BB20 5E316/CC16 5E316/EE21 5E316/GG28 5E316/HH22 5E316/HH31 5E316/JJ02 5E316/JJ03 5E316/JJ12 5E316/JJ13 5E316/JJ25 5E316/JJ27 5F849/BA18 5F849/BA25 5F849/BB03 5F849/BB08 5F849/JA01 5F849/JA09 5F849/XB02		
代理人(译)	佐藤隆久		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

#### 摘要(译)

要解决的问题：提供一种具有减小的长度并且应用于医疗电子内窥镜等的微型CCD图像拾取装置。超小型CCD图像拾取装置（1）具有光学玻璃（11），CCD芯片（12）和沿其纵向方向按以下顺序布置的层压电路板（15），并且还具有CCD芯片（12）。TAB带13用于连接安装在层压电路板15上的电子电路。层叠电路基板15是通过层叠多个绝缘电路基板而形成的，该多个绝缘电路基板具有：电子电路，该电子电路包括在与长度方向正交的径向上安装有配线图案的电子电路；以及至少一个通过在径向上凹陷而形成的电路。它具有空腔153。至少一个小芯片部件16被安装在空腔153中，并且至少一个芯片部件17被安装在层叠电路板15的在空腔153上方的表面上。将电子电路层压在层压电路板15上，并且沿径向方向布置芯片部分16和17，以缩短微型CCD图像拾取装置1的长度。



